XMOS、DSP Concepts合作解锁音频和语音DSP应用程序

xcore®.ai平台和Audio Weaver软件的结合通过完全集成的BOM优化解决方案实现快速上市

**英国布里斯托尔，2024年3月25日** – 今天，专精于AI（人工智能）和半导体的XMOS宣布与嵌入式音频软件专业公司DSP Concepts建立合作关系。 合作协议让音频专业人员得以将XMOS的高度确定性、低延迟的xcore.ai[平台](https://www.xmos.com/dsp)与DSP Concepts的Audio Weaver软件相结合，这将使用户能够在单个画布上轻松利用多核心以图形方式设计和调试音频和语音解决方案。

Xcore.ai将边缘AI、DSP（数字信号处理器）、控件和IO（输入/输出）集成在单个设备中，是一款专为智能物联网设计的高性能多用途处理器。其完全可在软件中配置，为快速上市的物联网产品提供了一个具有成本效益的多功能平台。

与此同时，Audio Weaver为音频产品开发提供从研发一直到生产的一站式解决方案。 通过将先进的图形设计工具与500多个预建模型结合在一起，设计师可以构建音频处理管道，同时几乎完全无需复杂的手动编程。

Audio Weaver使编程过程变成一种拖放操作，而xcore.ai仅通过软件就实现了完全定制，这两项解决方案双剑合璧，在音频和语音产品的设计方面提供了前所未有的灵活性和便利性，降低了BOM（物料）成本并加快了上市时间。

工程师可以通过XMOS的xcore.ai多声道音频评估板以及受客户驱动的完全产品化软件开发套件（SDK）来利用这种组合。 它还汇集了两个平台的强大支持网络和工程社区。

DSP Concepts首席执行官Chin Beckmann表示： “音频创新应该是简单的，这样音频工程师才能专注于让自己制作的产品实现差异化。Audio Weaver专为简化设计流程构建：可视化方法、多种部署选项以及与芯片合作伙伴的深度集成都有助于将重点放在产品上，而不是放在繁琐的开发过程上。XMOS的灵活性恰恰让这种优势如虎添翼。”

XMOS营销和产品管理执行副总裁Aneet Chopra表示：“在整个物联网领域的市场机会众多，多功能性一直是XMOS的优先事项，设计师和工程师需要不付出高昂费用就能够更改设计和探索新的创意。与DSP Concepts的这种合作关系是这一旅程中的最新里程碑，这为设计师提供了更多工具，让他们可以利用这些工具改进设计，快速将新的、有影响力的应用程序推向市场。”

在即将在<https://w.dspconcepts.com/xmos-webinar>举行的网络研讨会上，XMOS和DSP Concepts将更详细地介绍介绍他们的合作伙伴关系，并提供有关其联合解决方案的更多信息。

如果您想表明对这个联合解决方案的兴趣，并更加详细地讨论您的需求，请点击[此处](https://www.xmos.com/dsp?utm_source=press+release&utm_medium=coverage&utm_campaign=DSP+Concepts)联系XMOS销售团队。

完

关于XMOS

作为一家处于智能物联网（IoT）前沿的科技创新公司，XMOS满足了不断变化的市场对灵活性和高性能计算的需求，以服务于包括语音、图像和环境感知在内的越来越广泛的智能应用。

公司具有独特灵活性的xcore处理器使产品设计人员能够通过软件定义的方法构建片上系统解决方案，从而通过具有成本效益和能源效率的差异化系统加快上市速度。

**媒体联系人**Mohammed Zaidi / Ben Musgrove

Wildfire
xmos@wildfirepr.com
+44 208 408 8000

关于DSP Concepts

DSP Concepts总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是嵌入式音频软件的全球领导者，也是Audio Weaver的创造者，这是一个让音频创新更加轻松的音频开发平台。DSP Concepts为工程团队提供实时工作流程，以快速设计、调试和调整音频产品，并部署到最受欢迎的数字信号处理器（DSP）和片上系统（SoC）。

**媒体联系人**Catherine Spain

cspain@dspconcepts.com

+1  408-747-5200